



*a

*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
2411 01	4	100

Verpackung: im Tablett
Packaging: in tray
Emballage: en tableau

2411 01

USB-2.0-Einbaukupplung Typ B, stehende Ausführung, für Leiterplatten

- 1. Temperaturbereich** -55 °C/+85 °C
- 2. Werkstoffe**
Kontaktträger PBT GF, V0 nach UL 94
Kontaktfeder CuSn, vergoldet
Lötanschluss CuSn, verzinkt
Gehäuse CuZn, vernickelt
- 3. Mechanische Daten**
Steckkraft ≤ 35 N
Ziehkraft ≥ 10 N
Steckzyklen 1500
Kontaktierung mit USB-Stecker 2431
- 4. Elektrische Daten**
Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom ≤ 1 A
Bemessungsspannung 30 V AC
Prüfspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

2411 01

USB 2.0 chassis socket type B, upright version, for printed circuit boards

- 1. Temperature range** -55 °C/+85 °C
- 2. Materials**
Insulating body PBT GF, V0 according to UL 94
Contact spring CuSn, gold-plated
Solder pin CuSn, tin-plated
Housing CuZn, nickel-plated
- 3. Mechanical data**
Insertion force ≤ 35 N
Withdrawal force ≥ 10 N
Mating cycles 1500
Mating with USB plug 2431
- 4. Electrical data**
Contact resistance ≤ 30 mΩ
Rated current ≤ 1 A
Rated voltage 30 V AC
Test voltage 500 V/60 s
Insulation resistance ≥ 100 MΩ

2411 01

Embase femelle USB 2.0 type B, version droite, pour cartes imprimées

- 1. Température d'utilisation** -55 °C/+85 °C
- 2. Matériaux**
Corps isolant PBT GF, V0 suivant UL 94
Ressort de contact CuSn, doré
Plot à souder CuSn, étamé
Boîtier CuZn, nickelé
- 3. Caractéristiques mécaniques**
Force d'insertion ≤ 35 N
Force de séparation ≥ 10 N
Nombre de manœuvres 1500
Raccordement avec connecteur mâle USB 2431
- 4. Caractéristiques électriques**
Résistance de contact ≤ 30 mΩ
Courant assigné ≤ 1 A
Tension assignée 30 V AC
Tension d'essai 500 V/60 s
Résistance d'isolement ≥ 100 MΩ